****

***【プレスリリース】***

2020年5月14　日

報道関係各位

\*本プレスリリースは、[独congatec AGが、2020年4月30日（現地時間）、ドイツで発表したプレスリリース](https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases/article/amd-ryzentm-based-congatec-com-express-module-for-the-industrial-temperature-range/)の抄訳です。

**コンガテック、工業用の温度拡張版に対応した
AMD Ryzen™ベースの COM Expressモジュールを発表
超頑強なクアッドコアモジュール**

**

高性能組込みコンピューティング製品のリーディングサプライヤである[congatec（コンガテック）](http://www.congatec.jp)は、AMD Ryzen™組込み型V1000シリーズプロセッサを搭載した[conga-TR4 COM Express Type 6モジュール](http://www.congatec.com/jp/products/com-express-type6/conga-tr4.html)を発表しました。本製品は-40°Cから+85°Cまでの工業用温度範囲に適応します。また低温域と高温域における高次の信頼性を検証できるよう、オプションにより温度ストレス試験サービスも提供可能です。本モジュールの4コア、8スレッド、8 GPU演算ユニットは、きわめて負荷の高いグラフィックスや演算処理にも対応し、定評あるAMD Zenマイクロアーキテクチャの強力な処理能力を最大限に引き出す超頑強なパッケージで提供します。イマーシブ（没入感）の高い4K UHDシステムを受動冷却のみで、そしてTDP（熱設計電力）を12Wから25Wまで拡張できます。本製品の最適な用途としては、組込みビジョンと人工知能（AI）を搭載した厳しい温度環境を必要とされるエッジコンピューティング、自律走行車、鉄道車両や貨物輸送車、石油・ガス産業の屋外装置、携帯用救命救急機器、報道車輌、セキュリティおよびビデオ監視装置、5Ｇ基地局用装置などが挙げられます。

conga-TR4 COM Express Type 6モジュールの最大パフォーマンスは、環境条件に応じて異なります。温度範囲が0度以下の場合で1.6 GHzから2.8 GHz（ターボブースト利用時）、温度範囲が0度超の場合は2.0 GHzから最大3.6 GHzまでです。優れたパフォーマンスと厳しい温度環境下で高信頼のconga-TR4コンピュータオンモジュール（CoM）シリーズは、従来よりリアルタイム設計に対応しています。また、エッジコンピューティング環境下では、シビアなリアルタイム処理が要求される仮想マシンのデプロイメントや負荷分散管理などをReal-Time Systems社のハイパーバイザにより容易に実現します。

**本製品の特長**

COM Express Type 6のピン配置に準拠する新型conga-TR4高性能モジュールは、最新のAMD Ryzen™ Embedded V1404Iマルチコアプロセッサをベースとし、工業用温度範囲に対応します。電力効率に優れた、最大2400 MT/秒の高速な32GBのデュアルチャネルDDR4メモリのほか、オプションのECCによりデータセキュリティを最大限にサポートします。AMD Radeon™ Vegaグラフィックスに8つの演算ユニットを統合した本製品は、組込み型グラフィックスの最先端モジュールです。4K UHD、10ビットHDR、DirectX 12、および3Dグラフィック用OpenGL 4.4に対応するディスプレイを、独立して最大4つまで接続できます。ビデオエンジンを搭載しているため、ハードウェア アクセラレーションによるHEVC（H.265）動画の双方向ストリーミングが可能です。またHSAおよびOpenCL 2.0に対応することで、ディープラーニングにかかる高負荷をGPUに振り分けることができます。セキュリティが最優先とされる用途では、統合されたAMD セキュア プロセッサが、ハードウェア アクセラレーションによるRSA、SHA、AES暗号化および復号を支えます。

新型conga-TR4は、キャリアボードに10 Gbit/秒のUSB 3.1 Gen 2、Power Delivery、およびDisplayPort 1.4など、いずれのUSB-C端子も実装できるので、たとえば、外部タッチスクリーンへも1本のケーブルで接続できます。パフォーマンス指向のその他のインタフェ-スとしては、1x PEG 3.0 x8、4x PCIe Gen 3、4x PCIe Gen 2、3x USB 3.1 Gen 2、1x USB 3.1 Gen 1、8x USB 2.0、2x SATA Gen 3、1x Gbit Ethernetが挙げられます。これらのインタフェースをSD、SPI、LPC、I²C用I/O、ならびにCPUの2つのレガシーUART、およびHDオーディオが補完します。オペレーティングシステムは、Linux、Yocto 2.0、Microsoft Windows 10のほか、オプションでWindows 7もサポートされます。

conga-TR4 COM Express Type 6コンピュータオンモジュールの構成には以下のバリエーションがあり、標準温度範囲用の構成も用意されます。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **プロセッサ** |  | **コア/スレッド数** |  | **クロック [GHz] （ベース/ブースト）** |  | **L2/L3 キャッシュ（MB）** |  | **GPU演算ユニット** |  | **TDP [W]**  |
| AMD RyzenEmbedded V1404I |  | 4 / 4 |  | 2.0 /3.6 (<0°C: 1.6/2.8) |  | 2 / 4 |  | 8 |  | 12 - 25 |
| AMD RyzenEmbedded V1807B |  | 4 / 8 |  | 3.35 / 3.75 |  | 2 / 4 |  | 11 |  | 35 - 54 |
| AMD RyzenEmbedded V1756B |  | 4 / 8 |  | 3.25 / 3.60 |  | 2 / 4 |  | 8 |  | 35 - 54 |
| AMD RyzenEmbedded V1605B |  | 4 / 8 |  | 2.0 / 3.6 |  | 2 / 4 |  | 8 |  | 12 - 25 |
| AMD RyzenEmbedded V1202B |  | 2 / 4 |  | 2.5 / 3.4 |  | 1 / 2 |  | 3 |  | 12 - 25 |

conga-TR4高パフォーマンスCOM Express Type 6モジュールの詳細については、<http://www.congatec.com/jp/products/com-express-type6/conga-tr4.html>をご覧ください。

**##**

*＊AMD、AMDのロゴ、 Radeon、Ryzenならびにそれらの組合せは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。*

**コンガテックについて**コンガテックはドイツのデッゲンドルフに本社を置くQseven、 COM Express、 SMARC 、SBCの産業用コンピュータモジュールの専業メーカです。コンガテックの製品は、産業用オートメーション、医療、アミューズメント、輸送、通信、計測機器やPOSなどの様々な用途に対応できます。コアな知識や技術ノウハウは、ドライバーやBSPのみならずユニークなBIOS機能も含まれています。デザイン・インの段階以降も、製品のライフサイクル・マネジメントを通してサポートします。弊社の製品は、長期間の提供・保守サービスおよび産業用の品質基準を満たしています。現在、コンガテックは日本、韓国、台湾、米国、オーストラリア、チェコ共和国と中国に販売拠点があります。詳しくは、 www.congatec.jp をご参照ください。

**■本製品に関するお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　担当：奥村

TEL: 03-6435-9250 Email: sales-jp@congatec.com

**■本リリースに関する報道関係者様からのお問合せ先**

コンガテック ジャパン株式会社　（同上） または

（広報代理）　プラップジャパン　高橋、谷本

Email: congatec@prap.co.jp